

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-007

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称/人员姓名	国金证券、东北证券、粤民投私募基金、深商中汇控股、绿野资本、恒邦兆丰基金、幸福时光基金、盈鼎基金、高林基金、泰聚基金、拓森投资、宇科实业、零日科技、维海投资、资瑞兴投资、深圳市商品交易市场联合会
时间	2025 年 6 月 26 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：冯学裕 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： Q1：目前公司业务增长主要靠哪些板块驱动？ A：从上半年经营情况来看，公司业务增长主要得益于以下二个方面的协同驱动：（1）半导体封装材料业务延续了自去年下半年以来的增长趋势，同比实现显著提升；（2）毛率相对较高的智能卡一站式服务订单同比增长。 Q2：智能卡业务的生产基地和销售情况如何？未来产能规划？ A：公司智能卡业务板块下设四大生产基地，分别位于深圳龙岗、印度尼西亚雅加达、印度新德里和宁波慈溪。2024 年，公司实现营业收入 3.60 亿元，其中智能卡业务是主要的收入来源，产品广泛应用于移动通讯、金融支付、社会公共事业领域。公司海外生产基地通过实施本土化运营策略，可有效缩短交付周期，现印度与印尼生产基地

	产能利用率达 70%-90%，公司外销业务占比长期超过 60%。在国内业务方面，公司持续深化与四大运营商的战略合作，同时积极拓展超级 SIM 卡创新应用场景，以提升产品附加值。 智能卡作为信息化基础设施的关键组成部分，已深度融入金融支付、移动通信、公共交通、安全认证等多个领域，目前全球智能卡市场需求稳定，公司将继续维持智能卡业务的现有产能规模，未来将重点推进产能效率优化与产业链整合升级。 Q3: 半导体封装材料业务的客户拓展情况如何？与液冷客户群体是否有重叠情况？ A: 公司半导体封装材料业务的核心客户为国内知名的功率半导体封装企业，并正稳步向海外大型封装集团拓展。目前，公司已实现引线框架和散热铜针底座的自主设计与量产落地，产品可满足 MOSFET、IGBT、SiC 及 IGBT 功率模块的封装应用需求。未来将重点推进高导热铜针式散热底板等产品的产业化落地，加速实现 SiC 和 IGBT 模块封装材料系统化解解决方案的应用部署，持续拓展行业头部功率模块客户及其工装配套供应体链体系，积极响应行业高性能、高可靠性发展的趋势，加快向高端模块封装材料领域转型升级。 半导体封装材料主要客户群体主要为功率半导体企业、封装厂及模块制造商，重点面向新能源汽车、光伏逆变器等领域的材料供应需求；液冷业务主要聚焦于服务器整机厂商，致力满足服务于 AI 服务器、高性能计算散热系统需求。目前，两类业务的客户群体尚无显著重叠，但公司正在积极推动两类场景在技术路径上的协同探索，未来在功率模块散热等交叉领域存在融合发展的可能性。 Q4: 引线框架业务切入原因？公司产品竞争力和市场前景如何？ A: 公司凭借多年在专用芯片封装领域的技术沉淀，拥有扎实的工艺研发与制造基础。2019 年，宁波澄天半导体产品项目竣工并投产，并于 2022 年实现产能的稳步提升。基于数字能源产业对功率半导体封装材料需求激增的深入研判，公司积极把握国产替代的战略机遇，向半导体封装材料领域拓展。自 2023 年起，公司半导体封装材料业务
--	--

	实现规模化量产。至 2024 年，该产品销售收入实现同比 467.80% 的增长；2025 年一季度，销售收入同比增幅进一步攀升至 236.78%。 公司半导体封装材料业务具备较强竞争优势，结合当前市场需求的持续旺盛及客户的高度认可，预计 2025 年该产品线将保持较强劲的增长动能，持续为公司经营业绩提供重要支撑。 Q5：液冷技术的应用领域、技术优势、目前进展及市场规模如何？ A：（1）应用领域：公司液冷业务聚焦于 AI 服务器、高性能计算液冷系统中的核心热交换部件——液冷板套件，主要包括液冷板主体、分水器、快接组件及辅助密封件等。主要应用于 AI 服务器、高性能计算等对散热性能要求极高的场景，并正向储能系统、新能源汽车等领域拓展。在液冷板开发中，公司根据客户不同需求，提供从热设计仿真、材料选型、加工制造到液冷路径优化的一体化技术解决方案，实现高性能与高性价比的平衡。 （2）技术优势：公司液冷散热产品采用自研的高性能制造工艺，在结构一体化、导热效率与耐压性能方面具备明显性能优势。与传统工艺相比，产品生产效率更高、制造成本更低，能够满足高功耗计算设备对散热性能的严格要求。 （3）目前进展：目前相关产品已完成多轮技术验证，并顺利通过部分客户的样品测试认证，正在进行首批产品生产交付，当前产能可满足初期订单需求，后续计划结合客户量产节奏，稳步推进液冷板的规模化交付，同时持续优化制程良率与成本结构，加强与高等院校的合作，进行液冷领域人才梯队建设，致力于在下一阶段大规模采购中，实现核心客户的正式量产导入。 （4）市场空间：随着 AI 服务器、高性能计算和数据中心等领域的对散热系统的性能需求日益增长，液冷散热技术逐渐成为行业发展的主流方向。液冷模块的单体价值不断攀升，系统级液冷解决方案预计将成为未来服务器整机制造商之间竞争的关键因素；公司专注于液冷产品领域，该产品线正处于高速增长的赛道。据市场研究机构预测，未来五年全球液冷市场规模将保持年均 20% 以上的高速增长。公司凭借
--	--

	在技术上的独特优势，市场前景极为广阔，未来将围绕核心客户，不断推进技术革新、产品个性化定制以及应用领域的拓展。公司将致力于以“技术领先、快速响应和规模化交付能力”为核心竞争力，力争在下一代高性能散热技术中占据稳定的市场份额，并推动液冷业务成为公司新的增长点。 Q6：智慧安全业务的安全防护栏项目的应用场景和商业模式如何？ A：公司安全防护栏项目聚焦高铁站台应用场景，通过智能化物理隔离解决方案，有效提升旅客安全防护效能，满足铁路系统对安全防护升级的战略需求。公司最新研发的新一代安全防护栏产品，经过多轮技术迭代，在安全性与防夹伤性能上实现显著突破。该产品采用“站台长度计价”的商业模式，并根据不同防护等级需求构建差异化浮动定制机制。近年来，公司持续强化该项目市场推广力度，协同相关主管部门共同稳步推进试验线建设工作。鉴于该项目兼具较高的技术壁垒与安全防护需求属性，其市场附加值提升空间显著。随着全国各地站点招标工作的有序推进，该业务不仅将进一步夯实公司在智慧交通安全领域的战略部署，更将为公司开辟新的业绩增长点。 Q7、超级 SIM 卡在铁路场景的应用进展？ 答：公司超级 SIM 卡项目，其核心应用场景主要以手机 SIM 载体为基础，使用手机 NFC 识别检票信息，通过闸机完成检票过程，实现用户的无感通行，是一种创新的过闸机验票方式，为出行提供极大的便捷。由于传统身份证检票存在体积小，易遗失风险，超级 SIM 卡能显著提升旅客的通行效率和出行体验。 该项目的实施与推广，依赖于国内运营商和铁路部门的紧密合作，目前正处于试点与应用阶段，主要面向国内市场。商业盈利模式主要涵盖卡销售、套餐分成、增值服务等方面。在功能拓展和附加值提升方面，超级 SIM 卡相较于传统智能卡具有明显优势，市场发展潜力更为广阔。目前公司与国内主要运营商建立了稳定且深入的合作关系，持续推动超级 SIM 卡在更多垂直场景中的应用落地，以提升产品价值、拓展业务范围，并为后续规模化复制与推广奠定坚实基础。
--	--

	Q8：公司未来业务发展的重点方向是什么？ A：公司未来业务发展将继续优化产品结构，以市场需求为导向，持续巩固以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在保持该业务市场份额稳健发展的同时，围绕半导体封装材料、数字与能源热管理及智慧安全等技术储备，积极拓展相关新兴业务领域，为公司业绩提供新的增长点。 Q9：公司是否考虑通过并购等方式加速业务发展？ A：公司坚持稳健经营策略，在发展上，不一味追求速度和规模，更注重稳健和长效。公司也密切关注产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持持续关注，公司将在充分评估风险和收益的前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 Q10、公司业务发展是否有融资计划？ A：公司现金流充足，现资产负债率相对较低，未来将根据业务拓展的需要进行审慎评估。如公司有扩产或其他重大融资活动，公司将及时依据法律法规要求进行信息披露。
风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-6-26